

Corporate Overview



AMKOR PHILOSOPHY

We build our business by helping our customers build theirs.

Technology Leaders

会社概要

1968年の設立から絶え間なく続いている改善、成長、革新の道のりは、私たちを世界の主要な半導体企業の戦略的かつ信頼できる製造パートナーへと導いてくれました。量産技術に関する当社独自の専門的見識と、業界が直面するさまざまな技術的課題を解決する能力、それこそが当社が誇る最大の強みです。

お客様や市場の要求レベルが高まるにつれ、半導体パッケージングはシステムのパフォーマンスにとって非常に重要な要素となっ



ています。最先端のパッケージ設計、組立、テストサービスを提供する世界最大級の半導体後工程サプライヤーとして、Amkorはイノベーティブな技術を現実のものにします。

製品ポートフォリオ

Amkorは1,000を超える様々なパッケージタイプとサイズを提供します。挿入型、表面実装型のリードフレームタイプから、高集積や多ピンのご要求にお応えする最新のCSP、BGAまで、幅広いバリエーションを取り揃えています。

当社の多様なポートフォリオには、スタックチップ、ウェハレベル、MEMS、フリップチップ、スルーシリコンビア (TSV) および2.5/3Dパッケージが含まれ、多くのお客様に後工程のシングルソースとしてご活用いただけます。旧来のレガシパッケージから先端のシステム・イン・パッケージ (SiP) まで、包括的な半導体パッケージングソリューションを提供いたします。当社のパッケージングサービスをご活用いただくことにより、お客様はAmkorをパッケージ技術の提案者、そしてテストパートナーとして利用し、自社のリソースを半導体設計やウェハ製造に集中させることが可能です。

TIME TO MARKETの短縮

当社のグローバルネットワークは、世界の主要なエレクトロニクス機器製造地域に戦略的に配置された、1,100万平方フィート (約100万平方メートル) におよぶ製造拠点、開発センター、営業およびサポートオフィスにより展開されています。当社の広大なネットワークは、大規模なオーダー管理を容易にし、お客様に短納期で製品を提供することが可能です。

パッケージ設計サービス

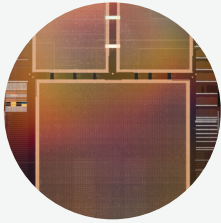
Amkorは基板やソフトウェアのサプライヤーと緊密に協業し、次世代のパッケージを設計します。当社の設計エンジニアはトレーニングと実績を積んだエキスパートであり、最新のツールとパッケージング技術に精通しています。これらの見識を活用することにより、当社のデザインセンターは設計サイクルタイムを短縮し、後工程のエキスパートとしてソリューションを提供いたします。

Products and Services

パッケージング

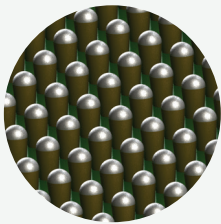
今日、電子機器は更なる低コスト、省スペースでありながら、より優れた機能と性能を要求されています。Amkorはこれらの複雑な要件を満たす半導体パッケージングソリューションを提案する、業界のトップランナーです。

主要製品



2.5/3D - スルーシリコンビア

スルーシリコンビア (TSV) 接続は、幅広い2.5D構造および3D構造パッケージングアプリケーションとアーキテクチャを供給するとともに、低消費電力とハイパフォーマンスを実現いたします。



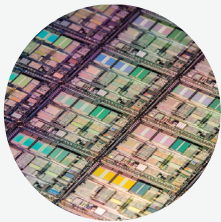
フリップチップ

Amkorはフリップチップ技術のリーディングプロバイダーであり続けるために日々研鑽を重ねています。フリップチップは、韓国、台湾および中国の工場で量産されています。



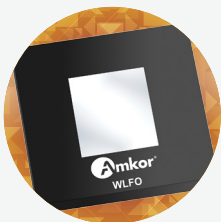
パワーディスクリート

Cuクリップを用いたパワーパッケージやモジュールなどに代表されるAmkorのハイパフォーマンス パワーディスクリートは、消費電力を重視するアプリケーションやモバイル機器向けに最適なソリューションを提供します。



システム・イン・パッケージ (SiP)

高度なシステムインテグレーションとコスト削減の両立という市場の要求が、システム・イン・パッケージ (SiP) の普及と更なる進化を牽引しています。



ウェハレベルパッケージ

ファンアウトからチップスケール、3D、システム・イン・パッケージ (SiP) に至るまで、幅広いウェハレベルパッケージソリューションを提供します。

アセンブリ

ワイヤボンディング、フリップチップ、また鉛フリー、グリーンパッケージなど、幅広いパッケージングソリューションを提供いたします。

ファイナルテスト

Amkorはさまざまな種類のファイナル、システムレベル、ウェハおよびストリップテストとともに、テスト後の最終出荷までを含めた完全なend-of-lineサービスをご提供いたします。



ロジスティクスおよび在庫管理

当社は世界中のお客様に、お客様の事業を発展させるために必要な電子部品を提供します。テープ&リール、ドライパック、倉庫管理サービス、またワールドワイドに製品を直送するドロップシップも承ります。

未来に備えること

3Dスタックなどの高度な技術への移行が活発になるにつれ、チップとパッケージのインタラクションの複雑さは著しく増してきています。お客様の求める、幅広い製品設計の要件を満たす包括的なソリューションの提供、Amkorはこの要求にお応えします。

Global Technology Leadership

本社

Amkor Technology, Inc.
2045 E Innovation Circle
Tempe, AZ 85284
USA
Tel: +1.480.821.5000
Fax: +1.480.821.8276

営業オフィス：米国

サンノゼ、カリフォルニア州
Amkor Technology, Inc.
25 Metro Drive, Suite 700
San Jose, CA 95110
USA
Tel: +1.408.496.0303
Fax: +1.408.496.0392

アーバイン、カリフォルニア州
Amkor Technology, Inc.
16795 Von Karman Avenue
Suite 260
Irvine, CA 92606
Tel: +1-949-724-9370
Fax: +1-949-724-8925

サンディエゴ、カリフォルニア州
Amkor Technology, Inc.
5465 Morehouse Drive
Suite 210
San Diego, CA 92121
Tel: +1-858-320-6280
Fax: +1-858-622-1841

ボストン、マサチューセッツ州
Amkor Technology, Inc.
105 Central Street
Suite 2300
Stoneham, MA 02180
Tel: +1-781-438-7800
Fax: +1-781-438-8414

オースティン、テキサス州
Amkor Technology, Inc.
8140 N. Mopac
Suite 150
Austin, TX 78759
Tel: +1-512-953-0701
Fax: +1-512-953-0717

営業オフィス：EMEA

Amkor Technology Holding
B.V., Germany
Werner-Eckert-Straße 8
81829 Munich
Germany
Tel: +49 (0) 89-1241498-40
Fax: +49 (0) 89-1241498-49

営業オフィス：中華圏

Amkor Technology Shanghai
Zhangjiang Hi Tech Park
Bldg. E, Chamtime Square
2889 Jinke Road
Room #504
Pudong, Shanghai 201203
China
Tel: +86-21-50644590
ext. 2340、4034、4221、4245
Fax: +86-21-5048-2522

営業オフィス：日本

Amkor Technology Japan, Inc.
105-0011東京都港区
芝公園2-6-3
芝公園フロントタワー14F
日本
Tel: 03.5425.2830
Fax: 03.5425.2831

営業オフィス：韓国

Amkor Technology Korea, Inc.
Songdo
150, Songdomirae-ro
Yeonsu-gu, Incheon 21991
Korea
Tel: +8232-728-4114

営業オフィス：東南アジア

Amkor Technology Singapore
Holding Pte. Ltd.
Valley Point Office Tower
491B River Valley Road
#12-03
Singapore 248373
Tel: +65.6211.3333
Fax: +65.6211.3388

営業オフィス：台湾

Amkor Technology Taiwan Ltd.
3F-1, No.1, Tai Yuen 2nd St.
Zhubei City, Hsinchu County
Taiwan 302
Tel: +886.3.598.2000
Fax: +886.3.560.1269



詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。

本文中の情報に関して、Amkorは、それが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もいたしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標は、それぞれの会社の財産です。© 2022 Amkor Technology, Incorporated. All Rights Reserved. BR302G-JP Rev Date: 01/22